

狭ピッチパッドオンビア FPC

高密度化に最適！

非常に狭いピッチで配置されたパッドに、直接ビア(Via)を有した FPC です。

製品特徴

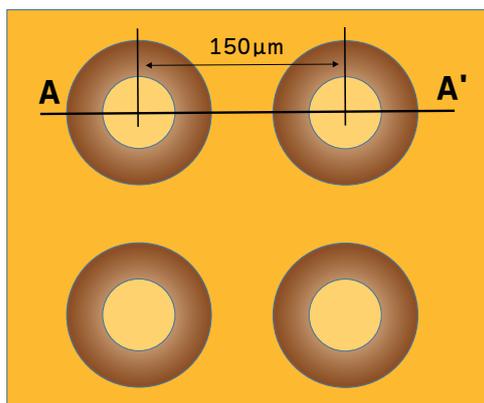
- 高密度実装が可能

150 μm の狭ピッチかつ 100 μm のパッドに対し、直接フィールドビアを設けることができるため、より高密度な部品実装が可能になります。

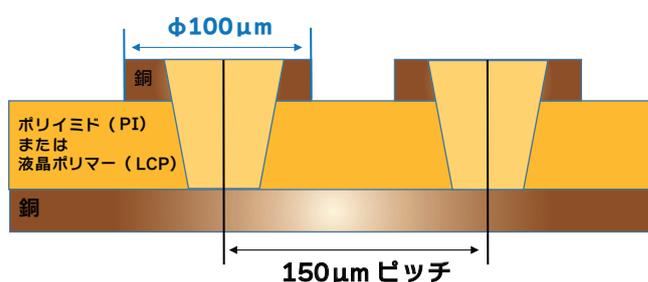
- 小型化が容易

高密度実装の実現により、製品の小型化を前提とした基板設計が可能です。

狭ピッチパッドオンビア構造例



AA'断面



仕様

ベース材 : ポリイミド (PI) 又は液晶ポリマー (LCP)

ベース厚み : 25 μm 、50 μm

導体厚み : ※14~24 μm

※Via径、材料によって推奨が異なりますので、個別相談となります



信頼性評価 (温度サイクル試験)

テストサンプル	基準	試験結果	試験方法
チェーン回路クーボン Via数 990穴 Viaピッチ 150 μm	初期導通抵抗から 変化率10%以内	合格	JIS C5016 9.1 -65°C/+125°C/100サイクル